

<<镀铜>>

图书基本信息

书名：<<镀铜>>

13位ISBN编号：9787122009296

10位ISBN编号：7122009297

出版时间：2007-9

出版时间：化学工业出版社

作者：霍栓成 编

页数：238

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<镀铜>>

内容概要

本书重点介绍了焦磷酸盐镀铜、硫酸盐镀铜、HEDP镀铜等多种无氰镀铜工艺和铜基合金电镀的工艺要点和操作条件，详细介绍了化学镀铜、电铸铜、电刷镀铜技术，铜及铜合金化学与电化学抛光的工艺规范，铜镀层的钝化、退除方法和技巧，列举了许多成熟的工艺配方和操作应用实例，同时分析了各种镀铜工艺常见的故障并指出其解决方法，便于读者在实践中学习掌握。

本书可供电镀企业的工程技术人员和一线工人阅读，也可供从事电镀研究的科研人员参考。

<<镀铜>>

书籍目录

<<镀铜>>

媒体关注与评论

前言镀铜在表面处理中占据重要地位。

长期以来镀铜工艺一直是以氰化物镀铜为主导的，当然也就成为了造成严重污染的镀种之一。

为适应环境保护的严格要求，按照电镀清洁生产的宗旨，电镀铜工艺的发展急需依靠工艺技术的进步，采用新技术替代有毒有害工艺，从源头削减污染，才能得以持续发展。

因此对无氰镀铜工艺的研究与推广尤为重要。

本书较详细地介绍了无氰镀铜中焦磷酸盐镀铜、硫酸铜镀铜、HEDP镀铜等多种镀铜工艺，还介绍了铜基合金的电镀工艺。

从理论和实践上全面阐述了各种工艺的配方及工艺条件，便于推广应用，希望对广大读者有所帮助。

本书可供电镀企业的工程技术人员和一线工人阅读，也可供从事电镀工艺研究的科研、技术人员参考。

。

本书由霍栓成主编。

第1章、第4章、第7章由张海燕编写，第2章由储荣邦、关春丽、储春丽等编写，第3章、第5章、第6章由霍栓成编写。

由白武康对本书进行校稿。

本书在编写过程中得到了郑振、顾卫忠及其他许多同志的帮助和支持，在此表示衷心的感谢。

由于表面工程技术的发展日新月异，加之编者水平有限，不当之处难免，敬请读者批评指正。

编者2007.4

<<镀铜>>

编辑推荐

《镀铜》重点介绍了焦磷酸盐镀铜、硫酸盐镀铜、H E D P 镀铜等多种无氰镀铜工艺和铜基合金电镀的工艺要点和操作条件，详细介绍了化学镀铜、电铸铜、电刷镀铜技术，铜及铜合金化学与电化学抛光的工艺规范，铜镀层的钝化、退除方法和技巧，列举了许多成熟的工艺配方和操作应用实例，同时分析了各种镀铜工艺常见的故障并指出其解决方法，便于读者在实践中学习掌握。

本书可供电镀企业的工程技术人员和一线工人阅读，也可供从事电镀研究的科研人员参考。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>